证券代码：688766　　证券简称：普冉股份

普冉半导体（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2026 年 11 月 18 日）

编号：2026-007

<table>
<tr><td>投资者关系活动类别</td><td>☐ 特定对象调研　　☐ 分析师会议
☐ 媒体采访　　☐ 业绩说明会
☐ 新闻发布会　　☑ 路演活动
☐ 现场参观
☑ 其他</td></tr>
<tr><td>参与单位</td><td>
<table>
<tr><td>东北电子</td><td>国联安基金</td><td>汇安基金</td></tr>
<tr><td>万家基金</td><td>Jefferies</td><td>BNP Paribas Asset Management</td></tr>
<tr><td>Lazard Asset Management</td><td>Oberweis Asset Management</td><td>SCGE Management</td></tr>
<tr><td>Sequoia Global Equities</td><td>Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd</td><td>Aberdeen Investment</td></tr>
<tr><td>东吴电子</td><td>农银汇理</td><td>德邦基金</td></tr>
<tr><td>长江资管</td><td>开源电子</td><td>天弘基金</td></tr>
<tr><td>中海基金</td><td>博道基金</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>2026 年 11 月 3 日~11 月 13 日</td></tr>
<tr><td>地点</td><td>反路演、策略会</td></tr>
<tr><td>上市公司接待人员姓名</td><td>IR 张子怡</td></tr>
<tr><td>投资者关系活动主要内容介绍</td><td>一、公司近况更新
公司就 2026 年三季度业绩情况做简要分享，对各条产品线近况及市场量价情况做汇报更新。</td></tr>
</table>

	二、投资者交流环节 **1、公司收购诺亚长天 49%股权并募集配套资金事项获得证监会同意注册批复，请介绍批复的主要内容以及本次交易后续的实施安排？** 公司于 2026 年 11 月 4 日收到中国证监会出具的《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3037 号），同意公司向珠海诺延、元禾璞华、横琴强科发行股份及可转换公司债券购买诺亚长天 49%股权，并同意公司发行股份募集配套资金不超过 7,700 万元。批复自下发之日起 12 个月内有效。11 月 17 日晚，公司公告该事项标的资产过户手续已办理完毕。公司将按照相关法律法规及股东会授权，在批复有效期内办理发行股份、可转债购买资产及募集配套资金的相关手续，具体发行时间表将根据审批进度、市场情况统筹安排，并严格履行信息披露义务，请关注公司后续公告。谢谢！ **2、本次交易完成后，对公司合并报表层面的业绩和每股收益有什么影响？** 本次交易完成后，公司对诺亚长天及其全资子公司 SHM 的持股比例将提升至 100%，原计入少数股东损益的部分将全部归属于上市公司股东。根据重组报告书备考数据，以 2026 年上半年为基准，交易完成后公司备考归母净利润为 13.10 亿元，较交易前增长 58.46%；备考基本每股收益由 5.58 元/股提升至 8.74 元/股，增长 56.63%。上述为备考口径数据，实际经营业绩请以公司定期报告为准。谢谢！ **3、本次募集配套资金不超过 7,700 万元，主要用途是什么？** 本次配套募资金额相对交易规模较小，主要用于本次交易相关的中介机构费用、税费等现金对价支付及标的公司项目建设等

	用途，具体用途和金额分配将在发行实施阶段按照监管要求予以明确并及时披露。谢谢！ **4、公司发行可转换公司债券购买资产，后续转股会对股本和每股收益产生怎样的摊薄影响？** 本次向交易对方发行可转债 1,387,289 张，转股期内的实际转股节奏取决于交易对方的自主选择及股价走势，转股时点存在不确定性。公司将在定期报告中持续披露可转债转股情况及对每股收益的影响。整体来看，本次交易以标的公司优质资产注入为前提，备考口径下每股收益增厚明显（+56.63%），即使考虑可转债逐步转股的摊薄，交易的经济性依然为正。公司也会在转股定价、发行条款设计上兼顾存量股东利益，请以公司公告及可转债募集说明书为准。谢谢！ **5、SHM 近年来业绩增长较快，这种高增长的可持续性如何？主要驱动因素是什么？** SHM 是 2024 年全球第四大 SLC NAND 厂商（TrendForce 数据，仅次于铠侠、美光和华邦），产品主要面向工控、通信、汽车等高可靠应用场景。2024 年、2025 年及 2026 年上半年，SHM 分别实现营业收入 8.63 亿元、13.49 亿元、23.46 亿元，主营业务毛利率由 24.13%提升至 58.91%。增长驱动主要来自两方面：一是行业层面，AI 算力基础设施建设带动存储供需结构变化，部分头部厂商调整产品与产能结构、减少或退出中小容量成熟品类供应，SLC NAND、eMMC 及 MCP 等品类供给持续收紧；二是公司层面，SHM 产品结构持续优化，eMMC 收入占比由 2024 年的 41.17%提升至 2025 年的 64.13%，2026 年上半年进一步升至 74.34%。需要提示的是，存储行业具有周期性，行业景气度与产品价格存在波动风险，公司将持续关注供需变化并动态优化产品结构与客户结构。谢谢！

	6、公司“存储”“存储+”“存储 X”三线战略中，与 SHM 的协同效应主要体现在哪些方面？ 本次收购是公司深化三线战略的关键举措，SHM 精准补齐公司在 2D NAND 领域的布局。协同效应主要体现在三个层面：一是技术层面，公司深耕芯片前端设计、具备 SONOS 与 ETOX 双工艺平台，SHM 擅长工程化落地、自研测试程序与固件算法，双方可构筑“芯片设计—固件算法—硬件封装”的技术闭环，加快新品迭代、提升量产良率并压缩成本；二是市场层面，公司深耕国内工控、消费电子市场并加速进军汽车电子、AI 服务器领域，SHM 在韩国、日本设有工程中心，销售网络覆盖亚洲、欧洲、北美，终端客户包括多家国际知名企业，整合后可实现“国内+国际”双轮驱动；三是产品层面，公司原有产品线与 2D NAND 两大产品线可构建平台化销售策略，提升客户粘性与议价能力。谢谢！ **7、近期公司股价波动较大，公司如何评估当前市值？是否有股东回报方面的安排？** 公司股价受宏观经济、行业景气、市场情绪等多重因素影响，短期波动受二级市场因素影响较大，请投资者注意投资风险。公司管理层始终专注于主业经营和长期价值创造：本次重组获批后，公司资产质量、盈利能力和每股收益均将得到实质性增厚，这是公司基本面层面重要的变化。在股东回报方面，公司将在兼顾业务发展资金需求的前提下，按照《公司章程》及相关承诺，统筹考虑利润分配等安排，并严格履行信息披露义务。公司不存在应披露而未披露的重大信息，相关信息请以公司公告为准。谢谢！ **8、公司近期筹划发行 H 股及发行科创债的原因和目的？** 两项安排均是公司在当前经营发展阶段，围绕“全球化战略

	＋科技创新投入”所作的资本规划，两者相互独立、融资方式与用途互补。 （一）关于筹划发行 H 股并在香港联交所上市 公司于 11 月 10 日披露提示性公告，正在筹划发行境外股份（H 股）并在香港联合交易所上市。主要目的包括： 1）匹配全球化发展战略与海外业务布局。公司通过收购珠海诺亚长天 51%股权，将 SHM 纳入合并范围后，海外业务规模与占比显著提升——2026 年前三季度公司营业收入 70.10 亿元中，SHM 贡献约 43.85 亿元；相应的海外客户覆盖、供应链协同及国际化人才团队建设需求上升，赴港上市与公司全球化发展布局相匹配。 2）充分借助国际资本市场的资源与机制优势，拓宽多元融资渠道、优化资本结构，为公司后续研发投入与业务扩张提供支持。 3）提升公司在国际市场的品牌影响力与核心竞争力，巩固行业领先地位，全面增强综合实力。 需要提示的是：目前公司正与相关中介机构就具体推进工作进行商讨，细节尚未确定；待方案确定后尚需提交董事会、股东会审议，并经中国证监会备案及香港联交所、香港证监会等监管机构批准或核准，最终能否实施存在较大不确定性。请投资者以公司后续公告为准。 （二）关于注册发行科创债（科技创新中期票据） 公司董事会同意拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 12.5 亿元（含）的中期票据，期限不超过 3 年，主要目的为： 1）积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，增强企业科技创新能力； 2）进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、降低财务费用，为并购及业务发展拓宽资金来源。

	募集资金在扣除发行费用后，将结合用款需求用于科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金、对外投资等合法合规用途。该事项尚需股东大会审议及交易商协会注册批准。 （三）整体逻辑 两项安排共同反映了公司在重大资产重组获得证监会注册批复、进入新一轮成长周期后的资金规划：H 股对应境外股权融资平台，科创票据对应境内低成本债权融资，均服务于研发投入、产能扩充与全球业务布局，且均不会导致公司控制权发生变化。谢谢！ **9、公司目前有什么新产品进展可以分享？** 公司自行研发设计的 SLC NAND 已实现产品量产：512Mbit 和 1Gbit 的高压、低压产品均已量产；2Gbit 产品已完成回片测试；更大容量产品在规划和开发中。自研产品量产有助于公司把握缺货窗口期、加速客户导入，同时提升产品自主率与盈利弹性。 后续在 2D NAND 领域，公司将与 SHM 从产品到业务层面展开有效协同，实现“1+1>2”：SHM 产品线覆盖 SLC NAND、eMMC、MCP 等产品，公司自研 SLC NAND 定位于自主可控的中小容量产品，形成双线供给能力，提升综合客户供应能力。 此外，MCU 产品线上，公司新推出基于 Arm Cortex-M52 内核的更高性能 MCU 产品，核心规格与应用情况如下： 1）性能与 AI 能力：工作频率最高达 420MHz，集成 Arm Helium 128 位矢量扩展，强化 DSP 与机器学习运算能力，支持端侧 AI 推理——语音唤醒、图像处理、异常检测等任务可在芯片本地运行，无需外挂 NPU；同时集成 2.5D GPU，支持图形渲染，一站式覆盖语音、图像处理任务。 2）存储与外设配置：延续公司“存储+”优势，内置 960KB

	双 Bank eFlash（支持 AB 分区 OTA）与 800KB SRAM，可选合封 16MB QSPI Flash 及 16MB PSRAM；显示接口覆盖 RGB、MIPI-DSI、LVDS、8080 等，支持高清 HMI 界面；安全方面集成 AES/SHA/RSA/SM2/SM3/SM4 硬件加密引擎。 3）目标市场：主打高端家电（带屏 HMI）、两轮车仪表、工业自动化及轻量级端侧 AI 场景。 4）量产状态：该产品已投入批量生产，并获得头部客户认可。 产品策略上，公司 MCU 聚焦通用市场，以消费领域为基石，重点拓展电机、家电、人机交互，并持续发力工业和能源市场、向车规延伸；产品结构正由 M0+为主转向 M4 及 M52 在中高端产品中的应用。谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 18 日